

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成21年11月12日

【会社名】 株式会社エフオーアイ

【英訳名】 F O I Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 奥村 裕

【本店の所在の場所】 神奈川県相模原市小山一丁目1番10号

【電話番号】 042 - 700 - 3010(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務管理部門長 上 畠 正 和

【最寄りの連絡場所】 神奈川県相模原市小山一丁目1番10号

【電話番号】 042 - 700 - 3010(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務管理部門長 上 畠 正 和

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】

募集金額	
ブックビルディング方式による募集	4,590,000,000円
売出金額	
(引受人の買取引受けによる売出し)	
ブックビルディング方式による売出し	997,050,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)	
ブックビルディング方式による売出し	1,010,140,000円

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## 1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成21年10月16日付をもって提出した有価証券届出書は、平成21年11月12日付で届出の効力を生じておりますが、当第2四半期連結会計期間(平成21年7月1日から平成21年9月30日まで)及び当第2四半期連結累計期間(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)の四半期連結財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく四半期レビュー報告書を受領したため、これに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を自発的に提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

### 第二部 企業情報

#### 第2 事業の状況

- 1 業績等の概要
- 2 生産、受注及び販売の状況
- 4 事業等のリスク
- 6 研究開発活動
- 7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

#### 第3 設備の状況

- 1 設備投資等の概要
- 2 主要な設備の状況

#### 第5 経理の状況

- 1 連結財務諸表等
  - (1) 連結財務諸表
  - (2) その他

[四半期レビュー報告書]

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_罫で示してあります。

(ただし、「第二部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等」については\_\_罫を省略しております。)

## 第二部 【企業情報】

### 第2 【事業の状況】

#### 1 【業績等の概要】

##### (1) 業績

(訂正前)

(省略)

当第1四半期連結累計期間（自平成21年4月1日至平成21年6月30日）

当第1四半期（平成21年4月1日～平成21年6月30日）におけるわが国経済は、昨年来の世界的な金融・経済危機による景気後退には一部に回復の兆しも見え始めたものの、在庫調整や設備投資の減少に加え雇用悪化に伴う個人消費の低迷等により、依然として厳しい状況が続いております。当社グループが参画しております半導体業界におきましては、メモリー価格の下落に歯止めがかかり、メーカーの設備稼働率も回復基調にあることから、今年度後半には一部メーカーにおいては投資が活発となるものと予測されます。

このような環境下において、当社グループは戦略的に高付加価値商品への投資を強める顧客に対し、集中的に営業展開をいたしました。

この結果、当第1四半期（4～6月）の連結経営成績につきましては、売上高2,430百万円、営業利益は548百万円、経常利益は376百万円となり、四半期純利益は209百万円となりました。

(訂正後)

(省略)

当第2四半期連結累計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）

当第2四半期（平成21年4月1日～平成21年9月30日）におけるわが国経済は、昨年来の世界的な金融・経済危機による景気後退には一部に回復の兆しも見え始めたものの、企業収益の縮小、設備投資の抑制、雇用情勢への不安等による個人消費の低迷は続いており、依然として不透明な状況が続いております。当社グループが参画しております半導体業界におきましては、メモリー価格の下落に歯止めがかかり、メーカーの設備稼働率も回復基調にあることから、今年度後半には一部メーカーにおいては投資が活発となるものと予測されます。

このような環境下において、当社グループは戦略的に先端微細化投資を強める顧客に対し、集中的に営業展開をいたしました。

この結果、当第2四半期（4～9月）の連結経営成績につきましては、売上高4,893百万円、営業利益は1,067百万円、経常利益は624百万円となり、四半期純利益は331百万円となりました。

## (2) キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

(省略)

当第1四半期連結累計期間（自平成21年4月1日至平成21年6月30日）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,883百万円減少の663百万円となりました。なお、当四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,932百万円の支出になりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益は376百万円となりましたが、法人税等の支払いによる856百万円の減少、売上債権の増加1,540百万円、たな卸資産の増加49百万円等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、17百万円の支出となりました。これは主に、定期預金の預入による支出16百万円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、65百万円の収入となりました。これは主に、株式発行による収入382百万円、短期借入金の純減少額236百万円、長期借入金の純減少額80百万円等があったことによるものであります。

(訂正後)

(省略)

当第2四半期連結累計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,941百万円減少の605百万円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における四半期連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,253百万円の支出になりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益は625百万円となりましたが、売上債権の増加が1,942百万円、たな卸資産の増加が338百万円、また法人税等の支払額が862百万円等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、99百万円の収入となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入133百万円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、212百万円の収入になりました。これは主に、株式発行による収入1,671百万円、短期借入金の純減少額1,036百万円、長期借入金の純減少額371百万円等があったことによるものであります。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

## (1) 生産実績

(訂正前)

当連結会計年度及び当第1四半期連結累計期間における生産実績は次のとおりであります。

事業	当連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	前年同期比 (%)	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
半導体製造装置事業(千円)	6,754,572	126.4	<u>1,385,783</u>
合計	6,754,572	126.4	<u>1,385,783</u>

- (注) 1 金額は、製造原価によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

当連結会計年度及び当第2四半期連結累計期間における生産実績は次のとおりであります。

事業	当連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	前年同期比 (%)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
半導体製造装置事業(千円)	6,754,572	126.4	<u>2,796,274</u>
合計	6,754,572	126.4	<u>2,796,274</u>

- (注) 1 金額は、製造原価によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 受注実績

(訂正前)

当連結会計年度及び当第1四半期連結累計期間における受注実績は次のとおりであります。

事業	当連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)				当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)	
	受注高 (千円)	前年同期比 (%)	受注残高 (千円)	前年同期比 (%)	受注高 (千円)	受注残高 (千円)
半導体製造装置事業	11,391,343	112.9	5,698,200	92.4	<u>2,892,837</u>	<u>6,160,300</u>
合計	11,391,343	112.9	5,698,200	92.4	<u>2,892,837</u>	<u>6,160,300</u>

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

当連結会計年度及び当第2四半期連結累計期間における受注実績は次のとおりであります。

事業	当連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)				当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	
	受注高 (千円)	前年同期比 (%)	受注残高 (千円)	前年同期比 (%)	受注高 (千円)	受注残高 (千円)
半導体製造装置事業	11,391,343	112.9	5,698,200	92.4	<u>5,606,996</u>	<u>6,413,450</u>
合計	11,391,343	112.9	5,698,200	92.4	<u>5,606,996</u>	<u>6,413,450</u>

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (3) 販売実績

(訂正前)

当連結会計年度及び当第1四半期連結累計期間における販売実績は次のとおりであります。

事業	当連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	前年同期比 (%)	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
半導体製造装置事業(千円)	11,855,960	124.8	2,430,736
合計	11,855,960	124.8	2,430,736

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

なお、下記の金額には、消費税等は含まれておりません。

相手先	前連結会計年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	
	販売高(千円)	割合(%)
Rexchip Electronics Corporation	3,654,000	38.5
Nanya Technology Corporation	1,350,000	14.2
Powerchip Semiconductor Corp.	1,320,000	13.9
PromOS Technologies Inc.	1,290,000	13.6
Semiconductor Manufacturing International Corporation	1,250,000	13.2

相手先	当連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	
	販売高(千円)	割合(%)
Rexchip Electronics Corporation	3,102,000	26.2
Nanya Technology Corporation	2,560,000	21.6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	2,500,000	21.1
Semiconductor Manufacturing International Corporation	2,119,350	17.9

相手先	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)	
	販売高(千円)	割合(%)
Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Corporation	1,550,000	63.7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	880,000	36.2

(訂正後)

当連結会計年度及び当第2四半期連結累計期間における販売実績は次のとおりであります。

事業	当連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	前年同期比 (%)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
半導体製造装置事業(千円)	11,855,960	124.8	4,893,184
合計	11,855,960	124.8	4,893,184

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

なお、下記の金額には、消費税等は含まれておりません。

相手先	前連結会計年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	
	販売高(千円)	割合(%)
Rexchip Electronics Corporation	3,654,000	38.5
Nanya Technology Corporation	1,350,000	14.2
Powerchip Semiconductor Corp.	1,320,000	13.9
ProMOS Technologies Inc.	1,290,000	13.6
Semiconductor Manufacturing International Corporation	1,250,000	13.2

相手先	当連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	
	販売高(千円)	割合(%)
Rexchip Electronics Corporation	3,102,000	26.2
Nanya Technology Corporation	2,560,000	21.6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	2,500,000	21.1
Semiconductor Manufacturing International Corporation	2,119,350	17.9

相手先	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	
	販売高(千円)	割合(%)
Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Corporation	2,350,000	48.0
Rexchip Electronics Corporation	1,294,000	26.4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	880,000	18.0

## 4 【事業等のリスク】

(訂正前)

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

また、必ずしも上記のリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から開示しておりますが、以下の記載事項は、当社株式への投資に関連するリスクを全て網羅するものではありません。

また、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、リスク発生の回避に努め、また、発生したリスクに可能な限り対処する方針がありますが、当社株式に対する投資判断は、以下の記載事項及び本書中の本項以外の記載内容を慎重に検討した上で行われる必要があります。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日（平成21年10月16日）現在において、当社グループが判断したものであります。

(省略)

## (3) 財務に関するリスク

(省略)

借入依存度及び財務制限条項に係るリスクについて

当社グループの営業循環は、受注・製造・出荷・回収までの期間が長く、多額の運転資金を要します。当社はこれらを主に銀行からの借入金、株式・社債の発行によって調達しており、下の表のとおり総資産に占める有利子負債の比率が相応に高い水準にあるため、金利変動が当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

回次	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
決算年月	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
総資産額 (千円)	11,231,023	11,528,588	20,342,243	22,896,107	29,177,829
有利子負債額 (千円)	5,090,450	4,595,830	8,245,475	9,797,000	12,921,173
有利子負債 依存度(%)	45.3	39.9	40.5	42.8	44.3

(注) 1 平成17年3月期、平成18年3月期及び平成19年3月期の財務諸表につきましては、監査を受けておりません。

2 平成20年3月期及び平成21年3月期については連結財務諸表に基づき記載しており、平成17年3月期、平成18年3月期及び平成19年3月期については提出会社の財務諸表に基づき記載しております。

また、当社の有利子負債には財務制限条項が付されているものがあり、この財務制限条項に抵触した場合には、当該有利子負債の一括返済を求められ、当社グループの資金繰りが悪化するほか、有利子負債の条件変更に伴い当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。本書提出日（平成21年10月16日）現在における有利子負債に係る財務制限条項は、次のとおりであります。なお、本書提出日（平成21年10月16日）現在、当該財務制限条項には抵触しておりません。

(省略)

## (6) 今後の事業展開

## 技術革新とライフサイクルの短期化について

当社グループは、先端の微細加工技術を搭載した製品を販売しておりますが、近年、エレクトロニクス産業全体の技術革新が加速化しており、製品のライフサイクルが短期化する傾向があります。当社グループは、今後も先端微細加工技術・装置の研究開発を強化する方針であります。

しかし、当社グループの予測よりも早く技術革新が起こった場合、先端装置の販売開始時期が遅れ、また、既存製品が陳腐化することが想定でき、その結果、市場での競争力を失い当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

## 生産能力の向上への対応について

当社グループは、本書提出日（平成21年10月16日）現在、相模原本社に最終組立拠点を設けておりますが、今後は同拠点のみならず協力企業への製造委託を行うことにより、生産能力を増強していく方針であります。この方針は、今後の「リピート機」販売比率の向上を前提としております。「リピート機」販売は、数年前の新設量産ライン向けに販売した「初号機」販売の増設ライン向けの販売であるため、販売価格、装置原価・仕様、販売時期等が概ね確定しており、生産・販売計画を見込みやすいと考えております。しかし、一方、「リピート機」販売は、「初号機」販売台数と比較して台数が多くなる可能性があるため、その時点での当社の資材調達体制、生産能力、財務状態により、大型受注に対応できない可能性があります。

従いまして、安定的な供給が実現しない可能性が顕在化した場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

（省略）

## (9) 資本政策

## ベンチャーキャピタルの持株比率について

平成21年9月30日現在における当社発行済株式総数は19,993,300株であり、うちベンチャーキャピタル及びベンチャーキャピタルが組成した投資事業組合等（以下、「VC等」といいます。）が所有している株式数は15,662,100株であり、その所有割合は78.3%であります。

一般的に、VC等による当社株式の所有目的は、株式上場後に当社株式を売却してキャピタルゲインを得ることです。従いまして、VC等は当社の株式上場後において所有する株式の全部又は一部を売却することが想定されます。株式上場後にVC等が保有する当社株式が売却されることにより、当社株式の需給バランスが短期的に悪化して当社株式の市場価格が変動する可能性があります。

また、中長期保有を目的とした安定株主比率が低いことにより、同業他社等から買収されるリスクがあり、当社グループ経営の安定性が阻害される可能性があります。

## ストック・オプションについて

当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しており、平成21年9月30日現在における新株予約権に係る新株発行予定株数は1,824,500株で、発行済株式総数19,993,300株に対する割合は9.1%となります。当社は、当該制度が役員や従業員等の業績向上に対する意欲を持たせることを目的とした有効な制度であると認識しており、今後も実施する可能性があります。従いまして、当該新株予約権が行使された場合及び新たに発行・行使された場合には当社の株式価値は希薄化することになります。

（省略）

(訂正後)

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

また、必ずしも上記のリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から開示しておりますが、以下の記載事項は、当社株式への投資に関連するリスクを全て網羅するものではありません。

また、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、リスク発生の回避に努め、また、発生したリスクに可能な限り対処する方針であります。当社株式に対する投資判断は、以下の記載事項及び本書中の本項以外の記載内容を慎重に検討した上で行われる必要があります。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日（平成21年11月12日）現在において、当社グループが判断したものであります。

(省略)

### (3) 財務に関するリスク

(省略)

借入依存度及び財務制限条項に係るリスクについて

当社グループの営業循環は、受注・製造・出荷・回収までの期間が長く、多額の運転資金を要します。当社はこれらを主に銀行からの借入金、株式・社債の発行によって調達しており、下の表のとおり総資産に占める有利子負債の比率が相応に高い水準にあるため、金利変動が当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

回次	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
決算年月	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
総資産額 (千円)	11,231,023	11,528,588	20,342,243	22,896,107	29,177,829
有利子負債額 (千円)	5,090,450	4,595,830	8,245,475	9,797,000	12,921,173
有利子負債 依存度(%)	45.3	39.9	40.5	42.8	44.3

(注) 1 平成17年3月期、平成18年3月期及び平成19年3月期の財務諸表につきましては、監査を受けておりません。

2 平成20年3月期及び平成21年3月期については連結財務諸表に基づき記載しており、平成17年3月期、平成18年3月期及び平成19年3月期については提出会社の財務諸表に基づき記載しております。

また、当社の有利子負債には財務制限条項が付されているものがあり、この財務制限条項に抵触した場合には、当該有利子負債の一括返済を求められ、当社グループの資金繰りが悪化するほか、有利子負債の条件変更に伴い当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。本書提出日（平成21年11月12日）現在における有利子負債に係る財務制限条項は、次のとおりであります。なお、本書提出日（平成21年11月12日）現在、当該財務制限条項には抵触しておりません。

(省略)

## (6) 今後の事業展開

## 技術革新とライフサイクルの短期化について

当社グループは、先端の微細加工技術を搭載した製品を販売しておりますが、近年、エレクトロニクス産業全体の技術革新が加速化しており、製品のライフサイクルが短期化する傾向があります。当社グループは、今後も先端微細加工技術・装置の研究開発を強化する方針であります。

しかし、当社グループの予測よりも早く技術革新が起こった場合、先端装置の販売開始時期が遅れ、また、既存製品が陳腐化することが想定でき、その結果、市場での競争力を失い当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

## 生産能力の向上への対応について

当社グループは、本書提出日（平成21年11月12日）現在、相模原本社に最終組立拠点を設けておりますが、今後は同拠点のみならず協力企業への製造委託を行うことにより、生産能力を増強していく方針であります。この方針は、今後の「リピート機」販売比率の向上を前提としております。「リピート機」販売は、数年前の新設量産ライン向けに販売した「初号機」販売の増設ライン向けの販売であるため、販売価格、装置原価・仕様、販売時期等が概ね確定しており、生産・販売計画を見込みやすいと考えております。しかし、一方、「リピート機」販売は、「初号機」販売台数と比較して台数が多くなる可能性があるため、その時点での当社の資材調達体制、生産能力、財務状態により、大型受注に対応できない可能性があります。

従いまして、安定的な供給が実現しない可能性が顕在化した場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

（省略）

## (9) 資本政策

## ベンチャーキャピタルの持株比率について

平成21年10月31日現在における当社発行済株式総数は19,993,300株であり、うちベンチャーキャピタル及びベンチャーキャピタルが組成した投資事業組合等（以下、「VC等」といいます。）が所有している株式数は15,662,100株であり、その所有割合は78.3%であります。

一般的に、VC等による当社株式の所有目的は、株式上場後に当社株式を売却してキャピタルゲインを得ることです。従いまして、VC等は当社の株式上場後において所有する株式の全部又は一部を売却することが想定されます。株式上場後にVC等が保有する当社株式が売却されることにより、当社株式の需給バランスが短期的に悪化して当社株式の市場価格が変動する可能性があります。

また、中長期保有を目的とした安定株主比率が低いことにより、同業他社等から買収されるリスクがあり、当社グループ経営の安定性が阻害される可能性があります。

## ストック・オプションについて

当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しており、平成21年10月31日現在における新株予約権に係る新株発行予定株数は1,798,000株で、発行済株式総数19,993,300株に対する割合は9.0%となります。当社は、当該制度が役員や従業員等の業績向上に対する意欲を持たせることを目的とした有効な制度であると認識しており、今後も実施する可能性があります。従いまして、当該新株予約権が行使された場合及び新たに発行・行使された場合には当社の株式価値は希薄化することになります。

（省略）

## 6 【研究開発活動】

(訂正前)

(省略)

当第1四半期連結累計期間（自平成21年4月1日至平成21年6月30日）当連結会計年度における当社グループが支出した研究開発費の総額は160百万円であります。研究開発活動の主な内容は、自社開発製品である300mmウェハ対応のエッチング装置及びアッシング装置に係る研究開発であります。

(訂正後)

(省略)

当第2四半期連結累計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）当連結会計年度における当社グループが支出した研究開発費の総額は338百万円であります。研究開発活動の主な内容は、自社開発製品である300mmウェハ対応のエッチング装置及びアッシング装置に係る研究開発であります。

## 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(訂正前)

文中の将来に関する事項は、本書提出日（平成21年10月16日）現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

(省略)

### (2) 財政状態の分析

(省略)

当第1四半期連結会計期間（自平成21年4月1日至平成21年6月30日）

当社グループの当第1四半期連結会計期間末の総資産は28,729百万円となり、前連結会計年度末に比べ447百万円減少いたしました。減少した主な要因は、未払法人税等の支払いに伴う現金及び預金の減少、短期借入金の返済による現金及び預金の減少によるものであります。

#### (流動資産)

当第1四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、28,402百万円（前連結会計年度末は28,832百万円）となり、429百万円減少いたしました。

減少の主な内訳は、現金及び預金の減少1,866百万円（前連結会計年度末2,661百万円から795百万円へ）売掛金の増加1,540百万円（前連結会計年度末22,895百万円から24,436百万円へ）であります。

#### (固定資産)

当第1四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、326百万円（前連結会計年度末は344百万円）となり、17百万円の減少となりました。

減少の主な内訳は、有形固定資産の減価償却によるものです。

#### (流動負債)

当第1四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、11,303百万円（前連結会計年度末は12,174百万円）となり、871百万円減少いたしました。

減少の主な内訳は、未払法人税等の減少759百万円（前連結会計年度末859百万円から100百万円へ）短期借入金の減少146百万円（前連結会計年度末9,616百万円から9,470百万円へ）であります。

#### (固定負債)

当第1四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、3,035百万円（前連結会計年度末は3,205百万円）となり、169百万円減少いたしました。

減少の主な内訳は、長期借入金の減少169百万円（前連結会計年度末2,724百万円から2,554百万円へ）によるものです。

#### (純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産の残高は、14,391百万円（前連結会計年度末は13,797百万円）となり、593百万円増加いたしました。

増加の主な内訳は、第三者割当増資による資本金及び資本剰余金の増加382百万円（前連結会計年度末11,964百万円から12,347百万円へ）及び当期純利益209百万円の計上等によるものであります。

## (3) 経営成績の分析

(省略)

当第1四半期連結累計期間（自平成21年4月1日至平成21年6月30日）（売上高）

当第1四半期連結累計期間における売上高は2,430百万円となりました。中国顧客の新設ライン向け絶縁膜エッチング装置及びアッシング装置の販売が増加しております。

（売上総利益）

当第1四半期連結累計期間の売上総利益は、1,000百万円となりました。

（販売費及び一般管理費）

当第1四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費は、452百万円となりました。主な内容としては、研究開発費160百万円、支払手数料140百万円であります。

（営業利益）

当第1四半期連結累計期間における営業利益は、548百万円となりました。

（経常利益）

当第1四半期連結累計期間における経常利益は、376百万円となりました。

（四半期純利益）

税金等調整前四半期純利益は376百万円となり、法人税等実質負担額は166百万円となりました。その結果、当第1四半期連結累計期間における四半期純利益は209百万円となりました。

(省略)

## (6) 経営戦略の現状と見通し

当社グループは、半導体製造工程の中でもプラズマ技術を応用した工程で使用される装置群の開発・製造・販売に特化しております。主要な経営戦略は、東アジアを拠点としている顧客を対象とする販売戦略と最先端プロセス開発及び製品開発を行う研究開発戦略に分かれます。

日本・台湾・韓国・中国等の東アジア地域の半導体産業の中でも、中長期的には特に台湾・中国が成長するとされており、当社グループはこのトレンドに合わせて、台湾・中国地域の顧客を重点顧客と捉え販売活動を強化しております。さらに今後は東アジアを拠点としていない半導体ロジックを製造している顧客に対する営業活動を強化していく方針です。

現在製品化されているものは、本書提出日（平成21年10月16日）現在において、絶縁膜エッチング装置、アッシング装置、表面酸化装置であります。今後はプラズマ技術を応用した工程で使用されるその他の装置群の分野に進出し、中長期的な成長を実現したいと考えております。

（訂正後）

文中の将来に関する事項は、本書提出日（平成21年11月12日）現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

（省略）

## （2）財政状態の分析

（省略）

当第2四半期連結累計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）

当社グループの当第2四半期連結会計期間末の総資産は29,176百万円となり、前連結会計年度末に比べ1百万円減少いたしました。また、負債総額は前連結会計年度末に比べ、2,004百万円減少の13,375百万円、純資産は2,003百万円増加の15,801百万円となり、この結果自己資本比率は54.1%となりました。

### （流動資産）

当第2四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、28,864百万円（前連結会計年度末は28,832百万円）となり、31百万円増加いたしました。

増加の主な内訳は、現金及び預金の減少2,040百万円（前連結会計年度末2,661百万円から621百万円へ）となりましたが、売掛金の増加1,942百万円（前連結会計年度末22,895百万円から24,838百万円へ）及び仕掛品の増加338百万円（前連結会計年度末3,325百万円から3,664百万円へ）等によるものであります。売掛金の増加は、当四半期連結累計期間の売上金額の増加に加え、売掛金回収期間が長期化する傾向にある顧客新設ライン向けの「初号機」売上が累積することが主な要因であります。

### （固定資産）

当第2四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、311百万円（前連結会計年度末は344百万円）となり、33百万円の減少となりました。

減少の主な内訳は、有形固定資産の減価償却によるものです。

### （流動負債）

当第2四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、10,681百万円（前連結会計年度末は12,174百万円）となり、1,492百万円減少いたしました。

減少の主な内訳は、未払法人税等の減少607百万円（前連結会計年度末859百万円から252百万円へ）、短期借入金の減少946百万円（前連結会計年度末9,616百万円から8,670百万円へ）等によるものであります。

### （固定負債）

当第2四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、2,693百万円（前連結会計年度末は3,205百万円）となり、511百万円減少いたしました。

減少の主な内訳は、長期借入金の減少461百万円（前連結会計年度末2,724百万円から2,262百万円へ）等によるものであります。

### （純資産）

当第2四半期連結会計期間末における純資産の残高は、15,801百万円（前連結会計年度末は13,797百万円）となり、2,003百万円増加いたしました。

増加の主な内訳は、第三者割当増資による資本金及び資本剰余金の増加1,671百万円（前連結会計年度末11,964百万円から13,635百万円へ）及び四半期純利益331百万円の計上等によるものであります。

## (3) 経営成績の分析

(省略)

当第2四半期連結累計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）（売上高）

当第2四半期連結累計期間における売上高は4,893百万円となりました。中国顧客の新設ライン向け絶縁膜エッチング装置及びアッシング装置の販売が増加しております。

（売上総利益）

当第2四半期連結累計期間の売上総利益は、1,987百万円となりました。

（販売費及び一般管理費）

当第2四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費は、920百万円となりました。主な内容としては、研究開発費338百万円、支払手数料280百万円であります。

（営業利益）

当第2四半期連結累計期間における営業利益は、1,067百万円となりました。

（経常利益）

借入金に伴う利息費用及び為替変動に伴う為替差損の発生等により、当第2四半期連結累計期間における経常利益は、624百万円となりました。

（四半期純利益）

税金等調整前四半期純利益は625百万円となり、法人税等実質負担額は294百万円となりました。その結果、当第2四半期連結累計期間における四半期純利益は331百万円となりました。

(省略)

## (6) 経営戦略の現状と見通し

当社グループは、半導体製造工程の中でもプラズマ技術を応用した工程で使用される装置群の開発・製造・販売に特化しております。主要な経営戦略は、東アジアを拠点としている顧客を対象とする販売戦略と最先端プロセス開発及び製品開発を行う研究開発戦略に分かれます。

日本・台湾・韓国・中国等の東アジア地域の半導体産業の中でも、中長期的には特に台湾・中国が成長すると言われており、当社グループはこのトレンドに合わせて、台湾・中国地域の顧客を重点顧客と捉え販売活動を強化しております。さらに今後は東アジアを拠点としていない半導体ロジックを製造している顧客に対する営業活動を強化していく方針です。

現在製品化されているものは、本書提出日（平成21年11月12日）現在において、絶縁膜エッチング装置、アッシング装置、表面酸化装置であります。今後はプラズマ技術を応用した工程で使用されるその他の装置群の分野に進出し、中長期的な成長を実現したいと考えております。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

(訂正前)

(省略)

当第1四半期連結累計期間（自平成21年4月1日至平成21年6月30日）

当第1四半期連結累計期間における設備投資等の主なものは、提出会社において、生産設備の改修工事440千円でありま  
す。

なお、重要な設備の除却または売却はありません。

(訂正後)

(省略)

当第2四半期連結累計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）

当第2四半期連結累計期間における設備投資等の主なものは、提出会社において、生産設備の改修工事440千円及び火災報  
知設備の増設620千円であります。

なお、重要な設備の除却または売却はありません。

## 2 【主要な設備の状況】

(訂正前)

## (1) 提出会社

平成21年6月30日現在

事業所名 (所在地)	事業の種類 別セグ メントの 名称	設備の内容	帳簿価額(千円)					従業員数 (名)
			建物 及び構築物	機械装置 及び運搬具	リース資産	その他	合計	
本社 (神奈川県相模原市)	半導体 製造装置 事業	事務所設備 及び 生産設備	48,255	132,587	7,744	14,939	203,526	186[3]

- (注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。  
 2 現在休止中の設備はありません。  
 3 上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。

## 賃借物件

事業所名 (所在地)	設備の内容	建物賃借 床面積(m <sup>2</sup> )	年間賃借料(千円)
本社 (神奈川県相模原市)	本社事務所工場	5,791.73	113,529

## リース物件

事業所名 (所在地)	設備の内容	リース期間	年間リース料 (千円)	リース契約残高 (千円)
本社 (神奈川県相模原市)	検査装置等	2～6年	53,414	159,320

## (2) 在外子会社

平成21年6月30日現在

会社名	事業所名 (所在地)	事業の種類 別セグ メントの 名称	設備の 内容	帳簿価額(千円)			従業員数 (名)
				建物 及び構築物	その他	合計	
東來科技 股?有限 公司	本社 (台湾 新竹市)	半導体製 造装置事 業	事務所 設備	68		68	11
FOI KOREA CORPORATION	本社 (大韓民 国城南 市)	半導体製 造装置事 業	事務所 設備	117	476	593	5

- (注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。  
 2 現在休止中の設備はありません。

(訂正後)

## (1) 提出会社

平成21年9月30日現在

事業所名 (所在地)	事業の種類 別セグ メントの 名称	設備の内容	帳簿価額(千円)					従業員数 (名)
			建物 及び構築物	機械装置 及び運搬具	リース資産	その他	合計	
本社 (神奈川県相模原市)	半導体 製造装置 事業	事務所設備 及び 生産設備	46,901	119,154	7,267	13,754	187,077	180[3]

- (注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。  
 2 現在休止中の設備はありません。  
 3 上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。

## 賃借物件

事業所名 (所在地)	設備の内容	建物賃借 床面積(m <sup>2</sup> )	年間賃借料(千円)
本社 (神奈川県相模原市)	本社事務所工場	5,791.73	113,529

## リース物件

事業所名 (所在地)	設備の内容	リース期間	年間リース料 (千円)	リース契約残高 (千円)
本社 (神奈川県相模原市)	検査装置等	2～6年	53,414	146,116

## (2) 在外子会社

平成21年9月30日現在

会社名	事業所名 (所在地)	事業の種類 別セグ メントの 名称	設備の 内容	帳簿価額(千円)			従業員数 (名)
				建物 及び構築物	その他	合計	
東来科技 股?有限 公司	本社 (台湾 新竹市)	半導体製 造装置事 業	事務所 設備	46		46	11
FOI KOREA CORPORATION	本社 (大韓 民国 城南市)	半導体製 造装置事 業	事務所 設備	104	424	528	5

- (注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。  
 2 現在休止中の設備はありません。

## 第5 【経理の状況】

### 2 監査証明について

(訂正前)

(省略)

(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第1四半期連結会計期間(平成21年4月1日から平成21年6月30日まで)及び当第1四半期連結累計期間(平成21年4月1日から平成21年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、公認会計士桜友共同事務所の公認会計士蓮見知孝氏及び公認会計士中川佳昭氏により四半期レビューを受けております。

(訂正後)

(省略)

(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第2四半期連結会計期間(平成21年7月1日から平成21年9月30日まで)及び当第2四半期連結累計期間(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、公認会計士桜友共同事務所の公認会計士蓮見知孝氏及び公認会計士中川佳昭氏により四半期レビューを受けております。

## 1 【連結財務諸表等】

### (1) 【連結財務諸表】

#### 【連結貸借対照表】

(訂正前)

(省略)

## 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第1四半期連結会計期間末  
(平成21年6月30日)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
現金及び預金	795,835
売掛金	24,436,711
仕掛品	3,375,262
その他	374,685
貸倒引当金	579,500
流動資産合計	28,402,995
固定資産	
有形固定資産	<sup>1</sup> 204,188
無形固定資産	11,941
投資その他の資産	110,862
固定資産合計	326,992
資産合計	28,729,987
<b>負債の部</b>	
流動負債	
買掛金	509,938
短期借入金	<sup>2, 3</sup> 9,470,360
未払法人税等	100,912
引当金	189,074
その他	1,033,136
流動負債合計	11,303,422
固定負債	
社債	470,000
長期借入金	<sup>3</sup> 2,554,620
その他	10,934
固定負債合計	3,035,554
負債合計	14,338,976
<b>純資産の部</b>	
株主資本	
資本金	6,201,158
資本剰余金	6,145,969
利益剰余金	2,030,959
株主資本合計	14,378,087
評価・換算差額等	
為替換算調整勘定	15,868
評価・換算差額等合計	15,868
新株予約権	28,791
純資産合計	14,391,011
負債純資産合計	28,729,987

[次へ](#)

(訂正後)

(省略)

[次へ](#)

## 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第2四半期連結会計期間末  
(平成21年9月30日)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
現金及び預金	621,611
売掛金	24,838,168
仕掛品	3,664,074
その他	320,441
貸倒引当金	579,500
流動資産合計	28,864,796
固定資産	
有形固定資産	187,652
無形固定資産	15,546
投資その他の資産	108,628
固定資産合計	311,827
資産合計	29,176,623
<b>負債の部</b>	
流動負債	
買掛金	535,921
短期借入金	8,670,360
未払法人税等	252,018
引当金	190,040
その他	1,033,622
流動負債合計	10,681,963
固定負債	
社債	420,000
長期借入金	2,262,730
その他	10,726
固定負債合計	2,693,456
負債合計	13,375,419
<b>純資産の部</b>	
株主資本	
資本金	6,846,674
資本剰余金	6,789,163
利益剰余金	2,153,483
株主資本合計	15,789,321
評価・換算差額等	
為替換算調整勘定	15,865
評価・換算差額等合計	15,865
新株予約権	27,747
純資産合計	15,801,203
負債純資産合計	29,176,623

[前へ](#)

【連結損益計算書】

(訂正前)

(省略)

【四半期連結損益計算書】  
【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
売上高	2,430,736
売上原価	1,429,766
売上総利益	1,000,970
販売費及び一般管理費	452,807
営業利益	548,162
営業外収益	
受取利息	621
還付加算金	1,983
その他	465
営業外収益合計	3,069
営業外費用	
支払利息	85,454
資金調達費用	38,294
為替差損	51,367
その他	58
営業外費用合計	175,175
経常利益	376,057
税金等調整前四半期純利益	376,057
法人税、住民税及び事業税	89,755
法人税等調整額	77,182
法人税等合計	166,937
四半期純利益	209,120

[次へ](#)

(訂正後)

(省略)

[次へ](#)

【四半期連結損益計算書】  
【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
売上高	4,893,184
売上原価	2,905,376
売上総利益	1,987,807
販売費及び一般管理費	920,685
営業利益	1,067,122
営業外収益	
受取利息	1,262
還付加算金	3,451
その他	868
営業外収益合計	5,582
営業外費用	
支払利息	168,619
資金調達費用	94,772
為替差損	146,468
その他	38,098
営業外費用合計	447,959
経常利益	624,745
特別利益	
新株予約権戻入益	1,035
特別利益合計	1,035
税金等調整前四半期純利益	625,780
法人税、住民税及び事業税	231,168
法人税等調整額	62,968
法人税等合計	294,137
四半期純利益	331,643

[前へ](#) [次へ](#)

## 【第2四半期連結会計期間】

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日)
売上高	2,462,447
売上原価	1,475,609
売上総利益	986,837
販売費及び一般管理費	467,877
営業利益	518,959
営業外収益	
受取利息	641
還付加算金	1,467
その他	403
営業外収益合計	2,512
営業外費用	
支払利息	83,164
資金調達費用	56,477
為替差損	95,101
その他	38,040
営業外費用合計	272,784
経常利益	248,688
特別利益	
新株予約権戻入益	1,035
特別利益合計	1,035
税金等調整前四半期純利益	249,723
法人税、住民税及び事業税	141,413
法人税等調整額	14,214
法人税等合計	127,199
四半期純利益	122,523

[前へ](#)

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(省略)

## 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当第1四半期連結累計期間  
(自平成21年4月1日  
至平成21年6月30日)

<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前四半期純利益	376,057
減価償却費	18,499
引当金の増減額（は減少）	36,111
受取利息及び受取配当金	621
支払利息	85,454
為替差損益（は益）	110
売上債権の増減額（は増加）	1,540,664
たな卸資産の増減額（は増加）	49,499
仕入債務の増減額（は減少）	89,439
その他	246,829
小計	989,385
利息及び配当金の受取額	455
利息の支払額	87,027
法人税等の支払額	856,587
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,932,545
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の預入による支出	16,680
有形固定資産の取得による支出	508
貸付けによる支出	1,150
貸付金の回収による収入	648
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,690
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入金の純増減額（は減少）	236,000
長期借入れによる収入	80,000
長期借入金の返済による支出	160,060
株式の発行による収入	382,561
その他	538
財務活動によるキャッシュ・フロー	65,963
現金及び現金同等物に係る換算差額	578
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	1,883,694
現金及び現金同等物の期首残高	2,546,997
現金及び現金同等物の四半期末残高	663,303

[次へ](#)

(訂正後)

(省略)

[次へ](#)

## 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前四半期純利益	625,780
減価償却費	37,063
引当金の増減額（は減少）	34,866
受取利息及び受取配当金	1,262
支払利息	168,619
為替差損益（は益）	217
売上債権の増減額（は増加）	1,942,149
たな卸資産の増減額（は増加）	338,310
仕入債務の増減額（は減少）	63,464
その他	338,723
小計	1,209,649
利息及び配当金の受取額	783
利息の支払額	182,466
法人税等の支払額	862,195
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,253,528
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の預入による支出	33,360
定期預金の払戻による収入	133,718
有形固定資産の取得による支出	1,128
貸付けによる支出	1,450
貸付金の回収による収入	1,828
その他	209
投資活動によるキャッシュ・フロー	99,816
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入金の純増減額（は減少）	1,036,000
長期借入れによる収入	80,000
長期借入金の返済による支出	451,950
社債の償還による支出	50,000
株式の発行による収入	1,671,271
その他	1,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	212,240
現金及び現金同等物に係る換算差額	124
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	1,941,346
現金及び現金同等物の期首残高	2,546,997
現金及び現金同等物の四半期末残高	605,651

[前へ](#)

(訂正前)

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第1四半期連結会計期間(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)

該当事項はありません。

【簡便な会計処理】

	当第1四半期連結会計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
棚卸資産の評価方法	当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第1四半期連結会計期間(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)

該当事項はありません。

## 【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日)	
1	有形固定資産の減価償却累計額 654,723千円
2	機動的かつ効率的な資金調達を目的に、金融機関6社と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当第1四半期連結会計期間末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 8,414,000千円 借入実行残高 8,414,000千円 差引額 0千円
3	財務制限条項 短期借入金及び長期借入金のうち、下記の契約については財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき期限の利益を喪失することがあります。 (短期借入金) (1)平成20年12月1日付コミットメントライン契約 (平成21年6月末実行残高 2,000,000千円) 決算期末における連結および単体の貸借対照表の資本の部の合計額がそれぞれ平成20年3月決算期の75%以上に維持すること。 (2)平成20年9月1日付コミットメントライン契約 (平成21年6月末実行残高 3,000,000千円) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益を損失としないこと。 (長期借入金) (1)平成19年8月22日付シンジケート・ローン契約 (平成21年6月末実行残高 1,758,720千円) 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、前決算期の末日または平成19年3月決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること。 各年度の決算期の経常利益について2期連続の赤字を回避すること。 売掛金の金額が、借入金及び社債の合計の金額を下回らないこと。

当第1四半期連結会計期間末  
(平成21年6月30日)

(2)平成20年9月17日付シンジケート・ローン契約  
(平成21年6月末実行残高 1,250,000千円)

単体及び連結の財務諸表において、各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、前決算期の末日または平成20年3月決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること。

単体及び連結の財務諸表において、各年度の決算期の経常利益について2期連続の赤字を回避すること。

単体または連結において、売掛金の金額が借入金及び社債の合計の金額を下回らないこと。

## (四半期連結損益計算書関係)

## 第1四半期連結累計期間

当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)	
販売費及び一般管理費の主なもの	
賞与引当金繰入額	9,743千円
研究開発費	160,954千円
支払手数料	140,234千円

## (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)	
現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係	
現金及び預金	795,835千円
計	795,835千円
預入期間が3か月超の定期預金	132,532千円
現金及び現金同等物	663,303千円

## (株主資本等関係)

当第1四半期連結会計期間末(平成21年6月30日)及び当第1四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)

## 1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当第1四半期 連結会計期間末
普通株式(株)	17,671,300

## 2 新株予約権等に関する事項

## ストック・オプションとしての新株予約権

会社名	目的となる株式の種類	目的となる株式の数(株)	当第1四半期 連結会計期間末残高 (千円)
提出会社			28,791
合計			28,791

## 3 配当に関する事項

該当事項はありません。

## 4 株主資本の著しい変動に関する事項

当社は、平成21年6月26日付で、株式会社カタリスタ他4社から第三者割当増資の払込を受けました。この結果第1四半期連結累計期間において資本金が191,625千円、資本準備金が190,936千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において資本金が6,201,158千円、資本準備金が6,145,969千円となっております。

(セグメント情報)

## 【事業の種類別セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)

当社及び連結子会社の事業は、半導体製造装置の開発・製造・販売及びそれに付随・関連する技術サービスを提供する半導体製造装置事業のみであり、当該事業以外に事業の種類がないため記載事項はありません。

## 【所在地別セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%を超えているため、記載を省略しております。

## 【海外売上高】

当第1四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)

	台湾	中国	その他	計
海外売上高(千円)	880,679	1,550,000	57	2,430,736
連結売上高(千円)				2,430,736
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	36.2	63.7	0.1	100.0

(注) 1 国又は地域の区分は、国別によっております。

2 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(1株当たり情報)

## 1 1株当たり純資産額

当第1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日)
812.74円

(注) 1株当たり純資産の算定上の基礎

項目	当第1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日)
純資産の部の合計額(千円)	14,391,011
純資産の部の合計から控除する金額(千円) 新株予約権	28,791
普通株式に係る第1四半期連結会計期間末の純 資産額(千円)	14,362,219
1株当たり純資産額の算定に用いられた第1四 半期連結会計期間末株式の数(株)	17,671,300

## 2 1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)	
1株当たり四半期純利益	12.29円
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	円

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

## 2 1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円)	209,120
普通株主に帰属しない金額(千円)	
普通株式に係る四半期純利益(千円)	209,120
普通株式の期中平均株式数(株)	17,019,874

## (重要な後発事象)

## 当第1四半期連結会計期間

(自平成21年4月1日  
至平成21年6月30日)

## (第三者割当による新株式の発行)

(1) 当社は、平成21年7月3日、平成21年7月6日及び平成21年7月8日開催の取締役会において、平成21年6月23日開催の取締役会で決議した発行枠のうち、下記の通り引受申込者に対する割当を決定いたしました。

発行株式数 普通株式2,268,000株

発行価額 1株につき555円

発行価額の総額 金1,258,740千円

資本組入額の総額 金630,504千円

(1株につき278円)

払込期日 平成21年7月10日

割当先及び割当株数

安田企業投資4号投資事業有限責任組合 261,900株、ミレニア二千投資事業有限責任組合255,000株、IC投資事業組合3号162,000株、MSIVC2008V投資事業有限責任組合127,400株、アント・リード・グローバル投資事業有限責任組合124,700株、投資事業有限責任組合ハンズオン1号113,300株、東洋証券3号投資事業組合90,000株、エーシーベンチャーズ6号投資事業組合90,000株、投資事業有限責任組合ハンズオン1・2号 66,900株、東京ディスカバリー投資事業有限責任組合65,900株、イノーヴァ1号投資事業有限責任組合65,100株、次世代経営者応援基金2005投資事業有限責任組合64,000株、アント・リード2号投資事業有限責任組合63,300株、ITYバリューアップ投資事業有限責任組合37,400株、TNPオンザロード1号投資事業有限責任組合36,100株、株式会社プラットホーム36,000株、インベスターインベストメントエフオーアイビーヴィ609,000株

(2) 平成21年7月3日、平成21年7月6日及び平成21年7月8日開催の取締役会において割当を行った新株式の払込みが、下記のとおり平成21年7月10日に実行されました。なお、一部の払込みが実行されず失権がありました。

発行株式数 普通株式1,659,000株

発行価額 1株につき555円

発行価額の総額 金920,745千円

資本組入額の総額 金461,202千円

(1株につき278円)

払込期日 平成21年7月10日

割当先及び割当株数

安田企業投資4号投資事業有限責任組合 261,900株、ミレニア二千投資事業有限責任組合255,000株、IC投資事業組合3号162,000株、MSIVC2008V投資事業有限責任組合127,400株、アント・リード・グローバル投資事業有限責任組合124,700株、投資事業有限責任組合ハンズオン1号113,300株、東洋証券3号投資事業組合90,000株、エーシーベンチャーズ6号投資事業組合90,000株、投資事業有限責任組合ハンズオン1・2号 66,900株、東京ディスカバリー投資事業有限責任組合65,900株、イノーヴァ1号投資事業有限責任組合65,100株、次世代経営者応援基金2005投資事業有限責任組合64,000株、アント・リード2号投資事業有限責任組合63,300株、ITYバリューアップ投資事業有限責任組合37,400株、TNPオンザロード1号投資事業有限責任組合36,100株、株式会社プラットホーム36,000株

失権した割当先及び株式数

インベスターインベストメントエフオーアイビーヴィ609,000株

(3) 当社は、平成21年7月3日開催の取締役会において、第三者割当増資による新株式の発行を決議しました。

発行株式数(上限) 普通株式7,500,000株

発行価額 1株につき555円

資本組入額 1株につき278円

払込期日 平成21年7月21日

当第1四半期連結会計期間  
(自平成21年4月1日  
至平成21年6月30日)

(4) 当社は、平成21年7月16日開催の取締役会において、平成21年7月3日開催の取締役会で決議した発行枠のうち、下記の通り引受申込者に対する割当を決定いたしました。

発行株式数 普通株式663,000株

発行価額 1株につき555円

発行価額の総額 金367,965千円

資本組入額の総額 金184,314千円

(1株につき278円)

払込期日 平成21年7月21日

割当先及び割当株数

インベスターインベストメントエフオーアイビーヴィ609,000株、株式会社マークスアセットマネジメント18,000株、デジタル・コンバージェンス投資事業有限責任組合36,000株

(5) 平成21年7月16日開催の取締役会において割当を行った新株式の払込みが、下記のとおり平成21年7月21日に実行されました。

発行株式数 普通株式663,000株

発行価額 1株につき555円

発行価額の総額 金367,965千円

資本組入額の総額 金184,314千円

(1株につき278円)

払込期日 平成21年7月21日

割当先及び割当株数

インベスターインベストメントエフオーアイビーヴィ609,000株、株式会社マークスアセットマネジメント18,000株、デジタル・コンバージェンス投資事業有限責任組合36,000株

(訂正後)

**【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】**

当第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年9月30日)

該当事項はありません。

**【簡便な会計処理】**

当第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年9月30日)

該当事項はありません。

**【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】**

当第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年9月30日)

該当事項はありません。

## 【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第2四半期連結会計期間末  
(平成21年9月30日)

1 有形固定資産の減価償却累計額 671,901千円

2 機動的かつ効率的な資金調達を目的に、金融機関3社と当座貸越契約を締結しております。当四半期連結会計期間末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 1,800,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 800,000千円

## 3 財務制限条項

短期借入金及び長期借入金のうち、下記の契約については財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき期限の利益を喪失することがあります。

## (短期借入金)

## (1)平成21年9月29日付タームローン契約

(平成21年9月末実行残高 6,614,000千円)

平成22年3月期の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。

平成22年3月期の決算期の末日における単体の貸借対照表における有利子負債の合計額を、売掛金及び仕掛品の合計額から買掛金の額を控除した金額の範囲内とすること。

平成22年3月期の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。

## (長期借入金)

## (1)平成19年8月22日付シンジケート・ローン契約

(平成21年9月末実行残高 1,623,400千円)

各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、前決算期の末日または平成19年3月決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること。

各年度の決算期の経常利益について2期連続の赤字を回避すること。

売掛金の金額が、借入金及び社債の合計の金額を下回らないこと。

当第2四半期連結会計期間末  
(平成21年9月30日)

(2)平成20年9月17日付シンジケート・ローン契約  
(平成21年9月末実行残高 1,176,450千円)

単体及び連結の財務諸表において、各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、前決算期の末日または平成20年3月決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること。

単体及び連結の財務諸表において、各年度の決算期の経常利益について2期連続の赤字を回避すること。

単体または連結において、売掛金の金額が借入金及び社債の合計の金額を下回らないこと。

## (四半期連結損益計算書関係)

## 第2四半期連結累計期間

当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	
販売費及び一般管理費の主なもの	
賞与引当金繰入額	14,991千円
研究開発費	338,911千円
支払手数料	280,651千円

## 第2四半期連結会計期間

当第2四半期連結会計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日)	
販売費及び一般管理費の主なもの	
賞与引当金繰入額	5,248千円
研究開発費	177,957千円
支払手数料	140,417千円

## (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	
現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係	
現金及び預金	621,611千円
計	621,611千円
預入期間が3か月超の定期預金	15,960千円
現金及び現金同等物	605,651千円

(株主資本等関係)

当第2四半期連結会計期間末(平成21年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年9月30日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当第2四半期 連結会計期間末
普通株式(株)	19,993,300

2 新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

会社名	目的となる株式の種類	目的となる株式の数(株)	当第2四半期 連結会計期間末残高 (千円)
提出会社			27,747
合計			27,747

3 配当に関する事項

該当事項はありません。

4 株主資本の著しい変動に関する事項

当社は、インベスターインベストメントエフオーアイビーヴィ他23社から平成21年6月26日、平成21年7月10日及び平成21年7月21日を期日として、第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、第2四半期連結累計期間において資本金が837,141千円、資本準備金が834,130千円増加し、当第2四半期連結会計期間末において資本金が6,846,674千円、資本剰余金が6,789,163千円となっております。

## (セグメント情報)

## 【事業の種類別セグメント情報】

当第2四半期連結会計期間(自平成21年7月1日至平成21年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年9月30日)

当社及び連結子会社の事業は、半導体製造装置の開発・製造・販売及びそれに付随・関連する技術サービスを提供する半導体製造装置事業のみであり、当該事業以外に事業の種類がないため記載事項はありません。

## 【所在地別セグメント情報】

当第2四半期連結会計期間(自平成21年7月1日至平成21年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年9月30日)

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%を超えているため、記載を省略しております。

## 【海外売上高】

当第2四半期連結会計期間(自平成21年7月1日至平成21年9月30日)

	台湾	中国	韓国	その他	計
海外売上高(千円)	1,445,746	1,014,531	1,697	471	2,462,447
連結売上高(千円)					2,462,447
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	58.7	41.2	0.1	0.0	100.0

(注) 1 国又は地域の区分は、国別によっております。

2 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年9月30日)

	台湾	中国	韓国	その他	計
海外売上高(千円)	2,326,425	2,564,531	1,697	529	4,893,184
連結売上高(千円)					4,893,184
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	47.6	52.4	0.0	0.0	100.0

(注) 1 国又は地域の区分は、国別によっております。

2 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

## (1株当たり情報)

## 1 1株当たり純資産額

当第2四半期連結会計期間末 (平成21年9月30日)
788.94円

(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎

項目	当第2四半期連結会計期間末 (平成21年9月30日)
純資産の部の合計額(千円)	15,801,203
純資産の部の合計から控除する金額(千円) 新株予約権	27,747
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	15,773,455
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末株式の数(株)	19,993,300

## 2 1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額

## 第2四半期連結累計期間

当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
1株当たり四半期純利益金額 18.06円
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 円

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

## 2 1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円)	331,643
普通株主に帰属しない金額(千円)	
普通株式に係る四半期純利益(千円)	331,643
普通株式の期中平均株式数(株)	18,360,662

## 第2四半期連結会計期間

当第2四半期連結会計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日)	
1株当たり四半期純利益金額	6.22円
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	円

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

2 1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目	当第2四半期連結会計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日)
四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円)	122,523
普通株主に帰属しない金額(千円)	
普通株式に係る四半期純利益(千円)	122,523
普通株式の期中平均株式数(株)	19,686,876

## (重要な後発事象)

当第2四半期連結会計期間  
(自平成21年7月1日  
至平成21年9月30日)

## (新株式の発行及び株式売出し)

当社株式は、平成21年10月16日に株式会社東京証券取引所の承認を得て、平成21年11月20日に東京証券取引所マザーズに上場を予定しております。当社はこの上場にあたって、平成21年10月16日及び平成21年10月30日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行及び株式売出しを決議いたしました。

## (1)公募による新株式の発行(ブックビルディング方式による募集)

募集株式の数 普通株式 6,750,000株

発行価格 1株につき 850円

引受価額 1株につき 782円

引受人より当社が受取る金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額(1株につき68円)は引受人の手取金となります。

発行価額 1株につき 680円

会社法上の払込金額であります。

発行価額の総額 4,590,000千円

払込金額の総額 5,278,500千円

増加する資本金の額 1株につき 391円

資本組入額の総額 2,639,250千円

払込期日 平成21年11月19日

株式受渡期日 平成21年11月20日

調達資金の用途 研究開発、借入金返済、運転資金

## (2)引受人の当社株主からの買取引受による株式売出し

売出株式の数 普通株式 1,173,000株

売出価格 1株につき 850円

株式受渡期日 平成21年11月20日

## (3)オーバーアロットメントによる株式売出し

売出株式の数 普通株式 1,188,400株

売出価格 1株につき 850円

株式受渡期日 平成21年11月20日

## (4)第三者割当増資による新株式の発行

当社では、東京証券取引所マザーズへの上場に伴い当社株主より当社普通株式を借入れたみずほインベスターズ証券株式会社が売出人となる上記(3)の当社普通株式のオーバーアロットメントによる株式売出しに伴い、第三者割当増資による株式の発行の決議を行っております。その概要は次のとおりであります。

発行株式の数 普通株式 1,188,400株

割当価格 1株につき 782円

払込金額 1株につき 680円

増加する資本金の額 1株につき 391円

払込期日 平成21年12月22日

割当先 みずほインベスターズ証券株式会社

調達資金の用途 研究開発

## (2)【その他】

(訂正前)

最近の経営成績及び財政状態の概況

(省略)

(訂正後)

該当事項はありません。

## 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成21年11月12日

株式会社 エフオーアイ  
取締役会 御中

公認会計士 桜友共同事務所

公認会計士 蓮見 知孝

公認会計士 中川 佳昭

私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エフオーアイの平成21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成21年7月1日から平成21年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エフオーアイ及び連結子会社の平成21年9月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営成績並びに第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

### 追記情報

重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、平成21年10月16日及び平成21年10月30日開催の取締役会にて新株式の発行及び株式売出しの決議を行っている。

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 1 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券届出書提出会社が別途保管しております。
- 2 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。